

2018年3月期第2四半期決算説明会資料

2017年12月19日



I. 当社の概要、当社の特徴

II. 2018年3月期第2四半期 決算概況

III. 2018年3月期 業績予想

IV. 中期経営計画と進捗状況

I

当社の概要、当社の特徴

○ 世界唯一の総合砥粒加工機メーカー

≫ 会社概要

会社名 英文	株式会社 岡本工作機械製作所 Okamoto Machine Tool Works, Ltd.
創業	大正15年11月
設立	昭和10年6月
資本金	48億8051万円
代表者	代表取締役社長 石井 常路
本社所在地	〒379-0135 群馬県安中市郷原2993番地
事業内容	各種研削盤・半導体関連装置の製造・販売
従業員数	連結：1,891名 単体：389名 ※平成29年9月末現在
関連会社	岡本工機株式会社 技研株式会社 OKAMOTO CORPORATION(米国) OKAMOTO (SINGAPORE) PTE, LTD. (シンガポール) OKAMOTO (THAI) CO., LTD. (タイ) OKAMOTO MACHINE TOOL EUROPE GMBH(ドイツ) OKAMOTO MACHINERY(CHANGZHOU) CO., LTD. (中国)



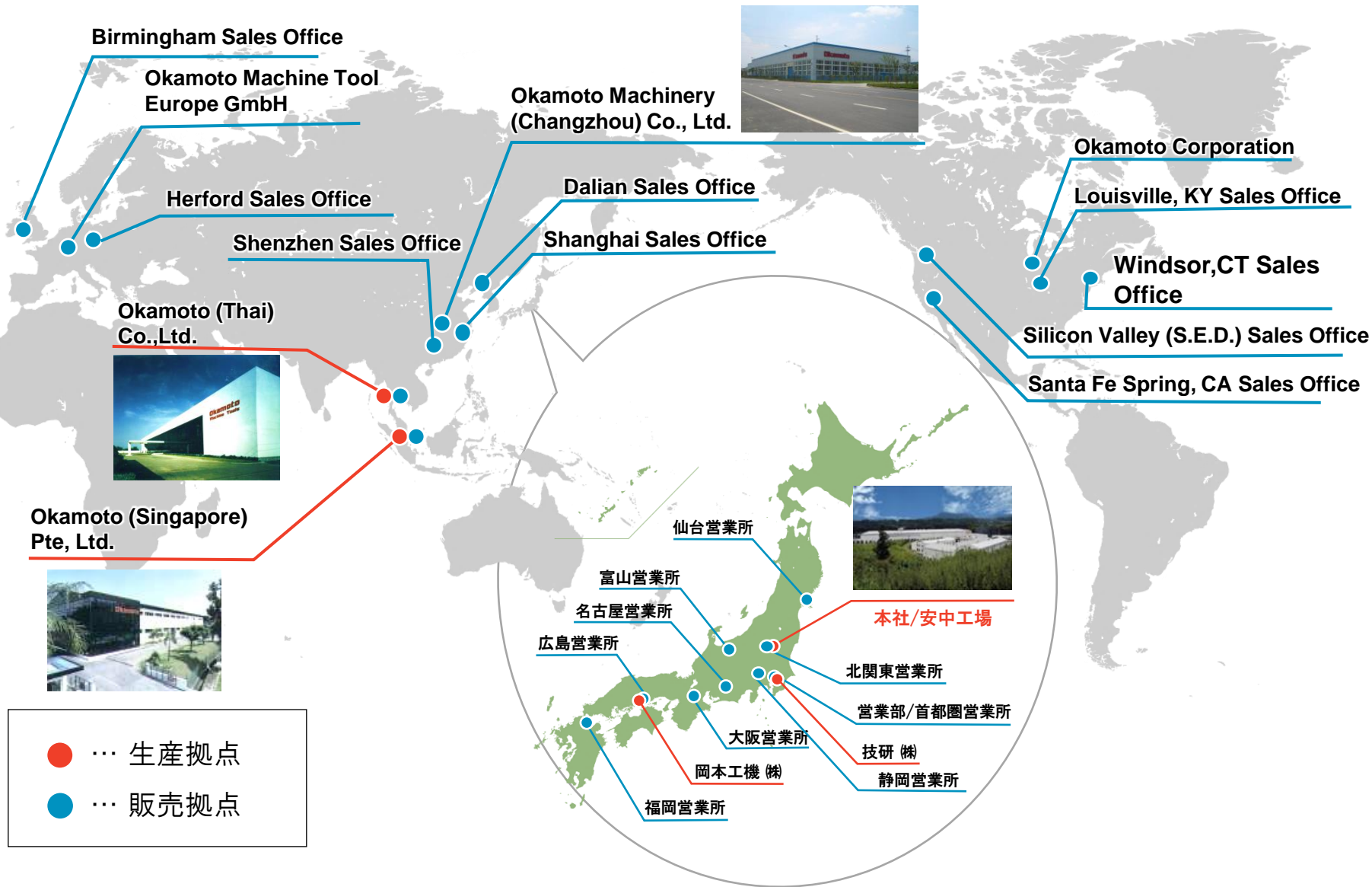
大正15年 (1926年)	岡本覚三郎が岡本専用工作機械製作所を創業
昭和5年 (1930年)	国産初の歯車研削盤 ASG-2型を完成
昭和10年 (1935年)	(株) 岡本工作機械製作所創立
昭和28年 (1953年)	国産初の平面研削盤PSG-6型完成
	
昭和30年 (1955年)	国産初の外周刃スライディングマシン PSG-3GE型を完成
昭和38年 (1963年)	東京証券取引所市場第二部上場
昭和43年 (1968年)	世界初のCNC成形研削盤 NFG-5型を完成
昭和47年 (1972年)	米国に、オカモト・コーポレーション設立
昭和48年 (1973年)	シンガポール工場完成
昭和57年 (1982年)	群馬県安中市に安中工場完成
昭和61年 (1986年)	タイ工場完成
平成4年 (1992年)	ドイツに、オカモト・ヨーロッパ設立
平成8年 (1996年)	半導体事業本部を設立
平成9年 (1997年)	全自動立型高精度平面研削盤の開発で日本機械学会 技術賞受賞 全自動高精度高能率CMP装置の開発で砥粒加工学会 技術賞受賞
平成12年 (2000年)	高精度成形研削盤 UPZシリーズを完成
平成13年 (2001年)	スキヤニングポリシャーGNX300Pを完成
平成14年 (2002年)	中国・上海に駐在員事務所開設
平成16年 (2004年)	超精密平面研削盤 UPGシリーズ発売開始
平成24年 (2012年)	本社を群馬県安中市(安中工場)に移転
平成28年 (2016年)	Si貫通電極ウェーハ全自動化薄化装置 JST課題採択



創業者 岡本覚三郎



○ 国内拠点、海外拠点

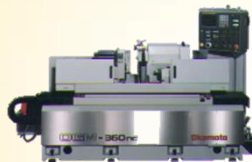




平面研削盤



門型研削盤



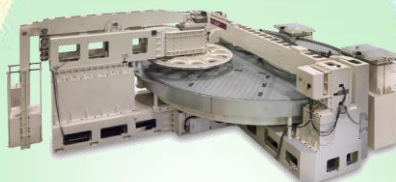
円筒研削盤



歯車研削盤



内面研削盤



9.6mピッチポリッシャー



5mラップ盤



スライサー



ラップ盤



ポリッシャー



グラインダー



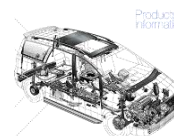
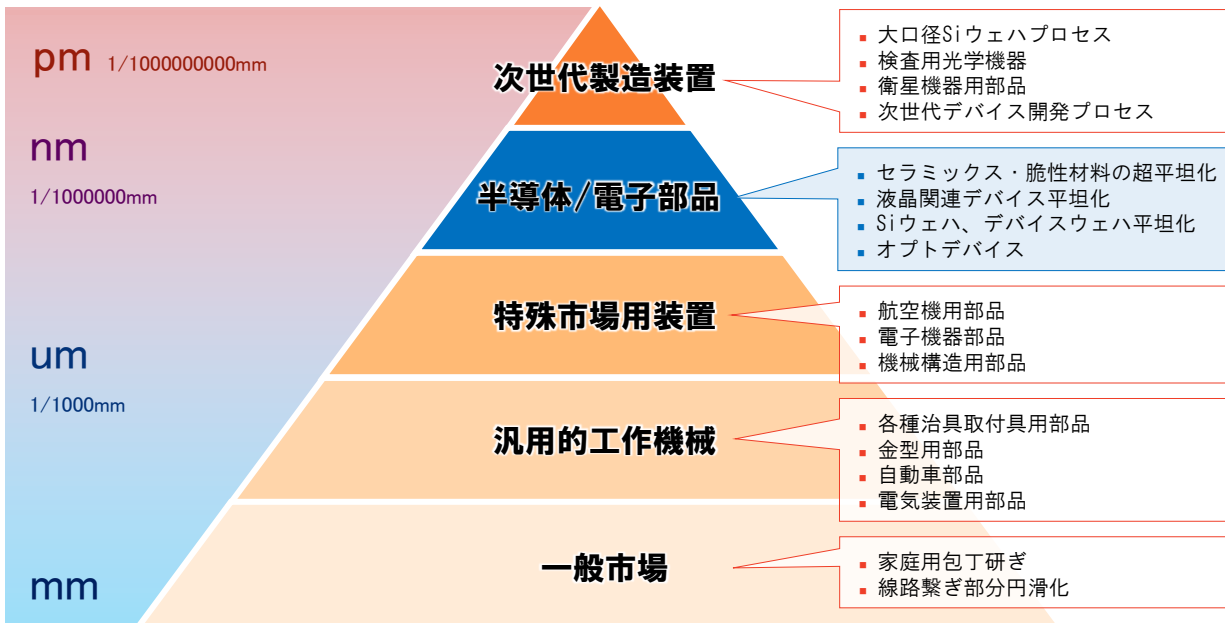
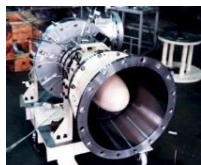
ファイナル
ポリッシャー

金属加工機 = 工作機械

ピッチポリッシャー
超大型ラップ盤

脆性材加工機 = 半導体製造装置

○ あらゆるニーズへの対応～ 豊富な機種構成



○ 平面研削盤のシェア ～ 幅広い顧客の広がり



1953年生産開始以来60年

- 出荷台数 : 総計50,000台以上
- 出荷国数 : 世界約80カ国
- ユーザー数 : 世界20,000社以上
- 国内推計シェア : 40%

研削盤の機種別分類

700万円

2000万円

5000万円



PSG-CA1 シリーズ
(高能率研削仕様)



スマートフォン
時計・カメラ
ロボット
自動車
他



UPZ-Li シリーズ
(リニアモータ駆動)



液晶テレビ
コンピュータ
時計・カメラ
自動車
他



UGM360NC
複合加工機



自動車
船舶
精密スピンドル
工作機械
他



UPG-NCシリーズ
超精密大型研削盤



航空機
液晶テレビ
測定器
工作機械
他

○ 半導体製造装置の機種別分類：主力製品

6000万円



GNX200B
SiCウェーハ用グラインダー



次世代パワー半導体SiC
電気自動車、電車、PC
他

15000万円



GDM300
ウェーハ薄化用
インライングラインダー



スマートフォン
PC
他



PNX332B
ファイナルポリッシャー



8"、12"Si 材料ウェーハ

23000万円



SPP800ATB
バッチ式ウェーハポリッシャー



スマートフォン
SAWフィルター

○ 半導体製造装置の機種別分類：関連製品

7000万円



SiSG156HT
太陽電池インゴット複合研削盤



太陽電池・ソーラーパネル

20000万円



PSG-CHシリーズ
門形平面研削盤



SPP3800
ピッチポリッシャー



液晶(LCD)テレビ・ディスプレイ

○ 当社の5つの特徴

- 1 **グローバルな販売網**
- 2 **タイ・シンガポール・アジアでの生産拠点の充実**
- 3 **一貫生産体制**
- 4 **伝統に裏打ちされた高い技術力**
- 5 **豊富な機種構成、幅広い客層、高い顧客対応力**

1 グローバルな販売網

Okamoto Machine Tool Europe GmbH



Okamoto Machine Tool (Shanghai) Office



Okamoto (Thai) Company Ltd.

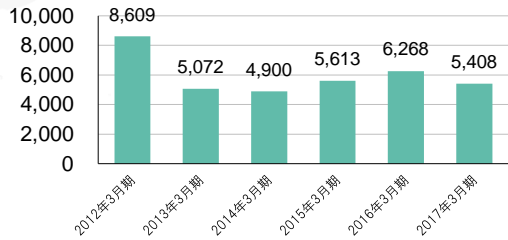
Okamoto (Singapore) Pte. Ltd.



Okamoto Corporation

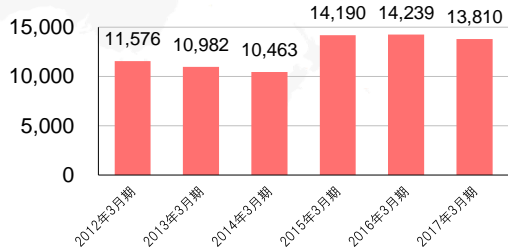
(単位:百万円)

アジア



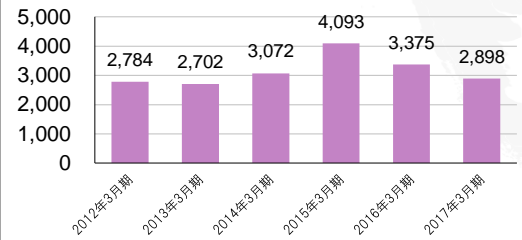
(単位:百万円)

日本



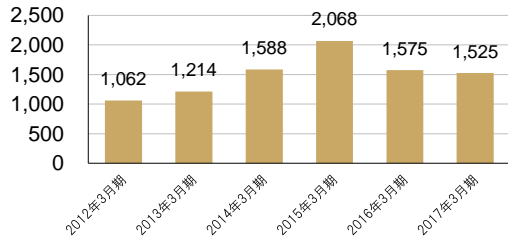
(単位:百万円)

北米



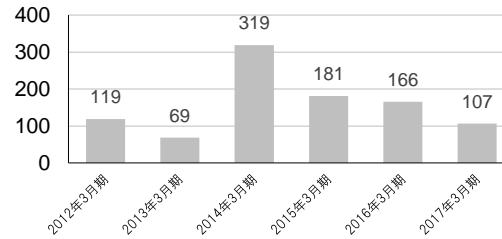
(単位:百万円)

欧州



(単位:百万円)

その他



2 タイ・シンガポール・アジアでの生産拠点



OKAMOTO(SINGAPORE) PTE, LTD

10 Riverside Road, Singapore 739082, Republic of Singapore

TEL : 65-62696426

FAX : 65-62690832

<http://www.okamoto.com.sg/>



OKAMOTO (THAI) COMPANY LTD.

174 Mu 2, Tambol Chamaeb, Amphur Wangnoi, Ayudthaya 13170, Thailand

TEL : 66-35-271187 ~ 90 FAX : 66-35-271191

<http://www.okamotothai.com/>



3 一貫生産体制



安中工場



基幹工場
(徹底した温度管理、クリーンルーム)

シンガポール

精密加工機的设计・生産



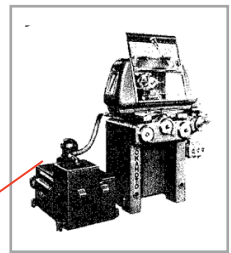
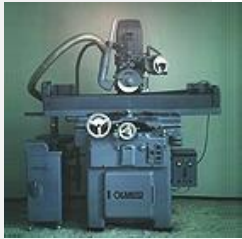
タイ

鑄物の生産、一般機の量産

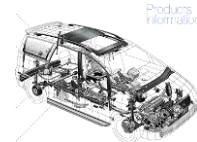
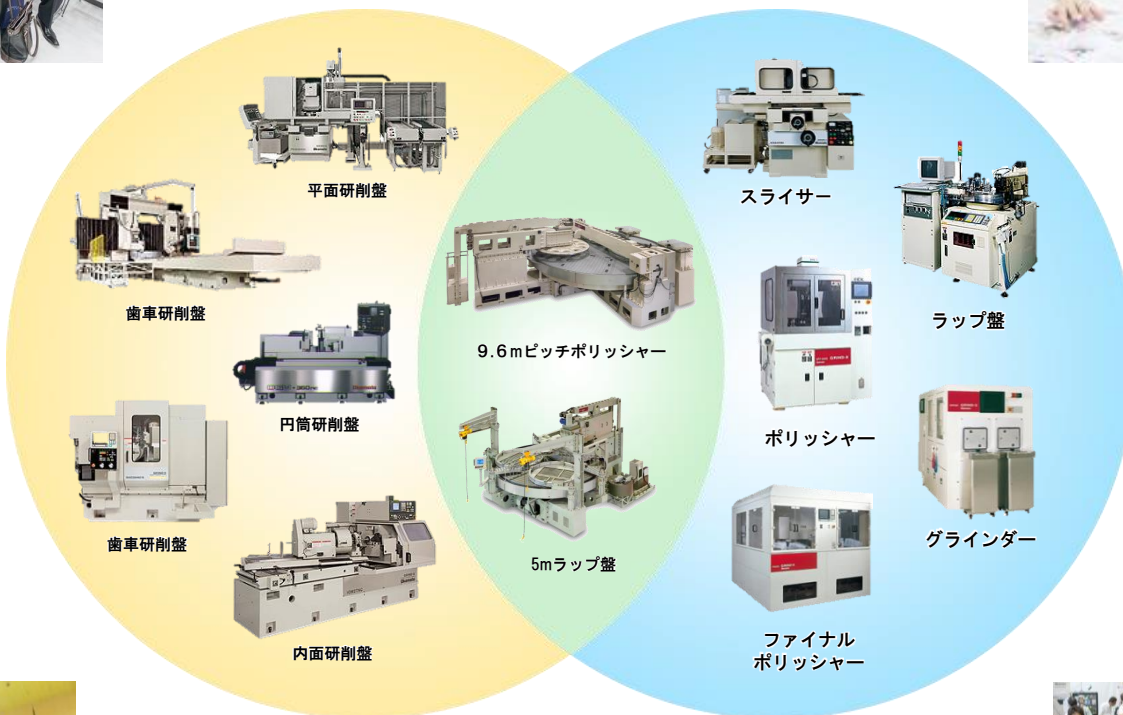


4 伝統に裏打ちされた高い技術力

大正15年 (1926年)	岡本覚三郎が岡本専用工作機械製作所を創業
昭和5年 (1930年)	国産初の歯車研削盤 ASG-2型を完成
昭和10年 (1935年)	(株) 岡本工作機械製作所創立
昭和28年 (1953年)	国産初の平面研削盤PSG-6型完成
昭和30年 (1955年)	国産初の外周刃スライディングマシン PSG-3GE型を完成
昭和38年 (1963年)	東京証券取引所市場第二部上場
昭和43年 (1968年)	世界初のCNC成形研削盤 NFG-5型を完成
昭和47年 (1972年)	米国に、オカモト・コーポレーション設立
昭和48年 (1973年)	シンガポール工場完成
昭和57年 (1982年)	群馬県安中市に安中工場完成
昭和61年 (1986年)	タイ工場完成
平成4年 (1992年)	ドイツに、オカモト・ヨーロッパ設立
平成8年 (1996年)	半導体事業本部を設立
平成9年 (1997年)	全自動立型高精度平面研削盤の開発で日本機械学会 技術賞受賞 全自動高精度高能率CMP装置の開発で砥粒加工学会 技術賞受賞
平成12年 (2000年)	高精度成形研削盤 UPZシリーズを完成
平成13年 (2001年)	スキヤニングポリシャーGNX300Pを完成
平成14年 (2002年)	中国・上海に駐在員事務所開設
平成16年 (2004年)	超精密平面研削盤 UPGシリーズ発売開始
平成24年 (2012年)	本社を群馬県安中市(安中工場)に移転
平成28年 (2016年)	Si貫通電極ウェーハ全自動化薄化装置 JST課題採択



5 豊富な機種構成、幅広い顧客、高い顧客対応力



II

2018年3月期第2四半期 決算概況

引き続き半導体関連と中国が好調

【国内市場】

- 工作機械業界や半導体関連装置業界向けに大型研削盤や高精度タイプの研削盤、ロータリー研削盤などの需要が高まり、売上は前年同期を上回り、受注も好調に推移
- 特に半導体関連装置はウェーハ、デバイス生産メーカーの増産対応などの設備投資により好調を継続。歯車、鋳物も前年同期を上回る

【海外市場】

- 北米は引き続き航空機、自動車部品などの業種を中心に堅調
- 欧州は需要は安定。ロシアは引き続き受注が低迷も、フランスやイタリアで汎用タイプの研削盤の受注が増加。半導体関連装置の貢献もあり前年同期を上回る
- アジア市場は中国で電気部品向け精密金型や自動化設備投資が旺盛、工作機械は売上、受注とも好調に推移。半導体関連装置も中国だけではなく東アジアで販売が高水準に推移

業績ハイライト

(単位:百万円、%)

	2016年9月	2017年9月	
	金額	金額	前期比増減率
売上高	10,909	13,742	+26.0%
売上総利益	3,278	4,175	+27.4%
販売費及び一般管理費	2,912	3,377	+16.0%
営業利益	366	797	+117.8%
経常利益	135	695	+414.8%
当期純利益	63	514	+715.9%

※小数点第2位を四捨五入

(単位:百万円)

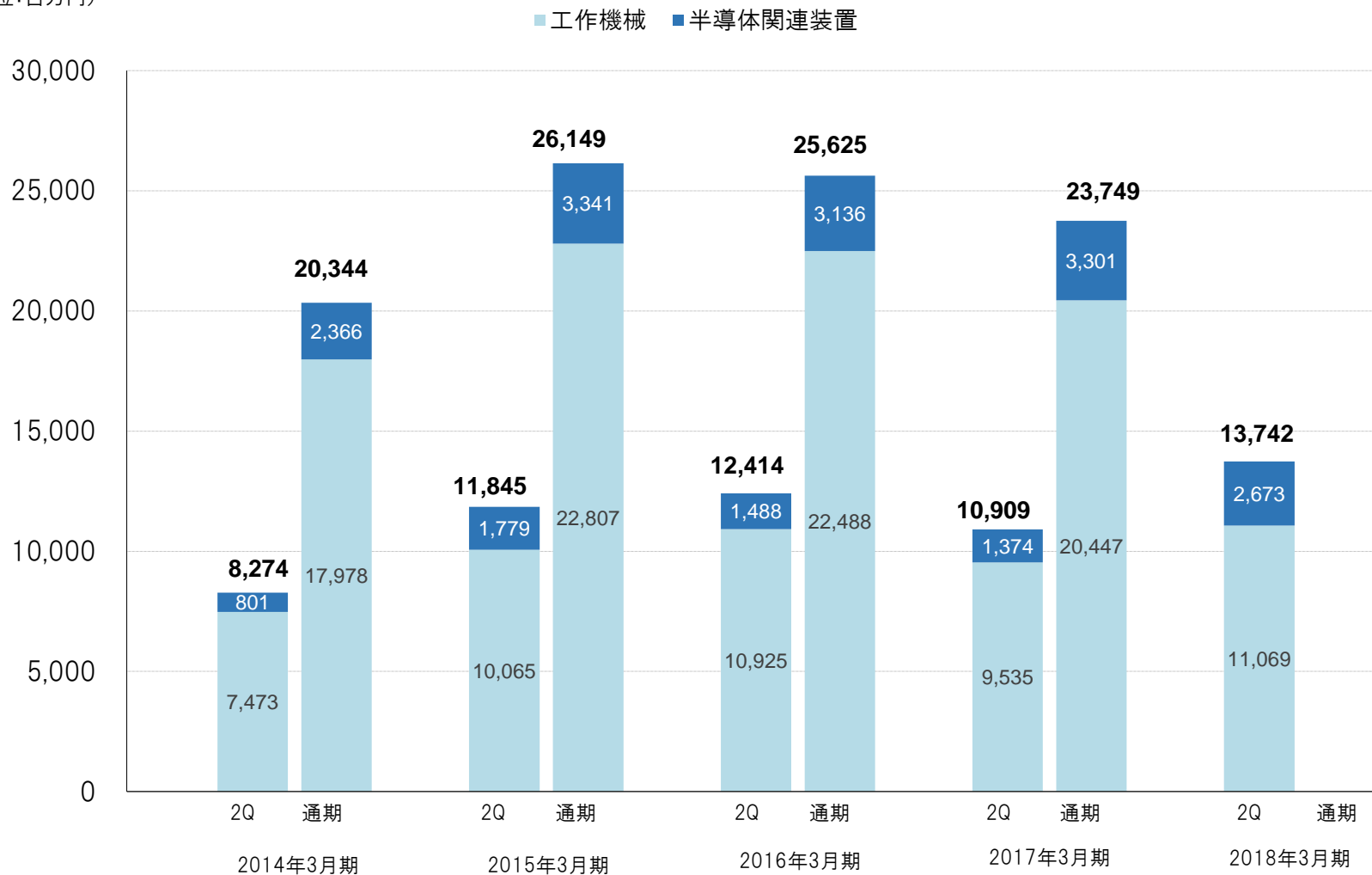
	2017年3月	2018年3月 (予想)
	金額	金額
設備投資額	960	1,235
減価償却費	1,158	1,126
研究開発費	106	119
為替レート	2016年9月	2017年9月
米ドル	105.39	111.29
シンガポールドル	77.56	81.13
ユーロ	117.69	127.77
タイバーツ	3.01	3.30
人民元	15.90	16.50

※期中の平均レートで記載しております。

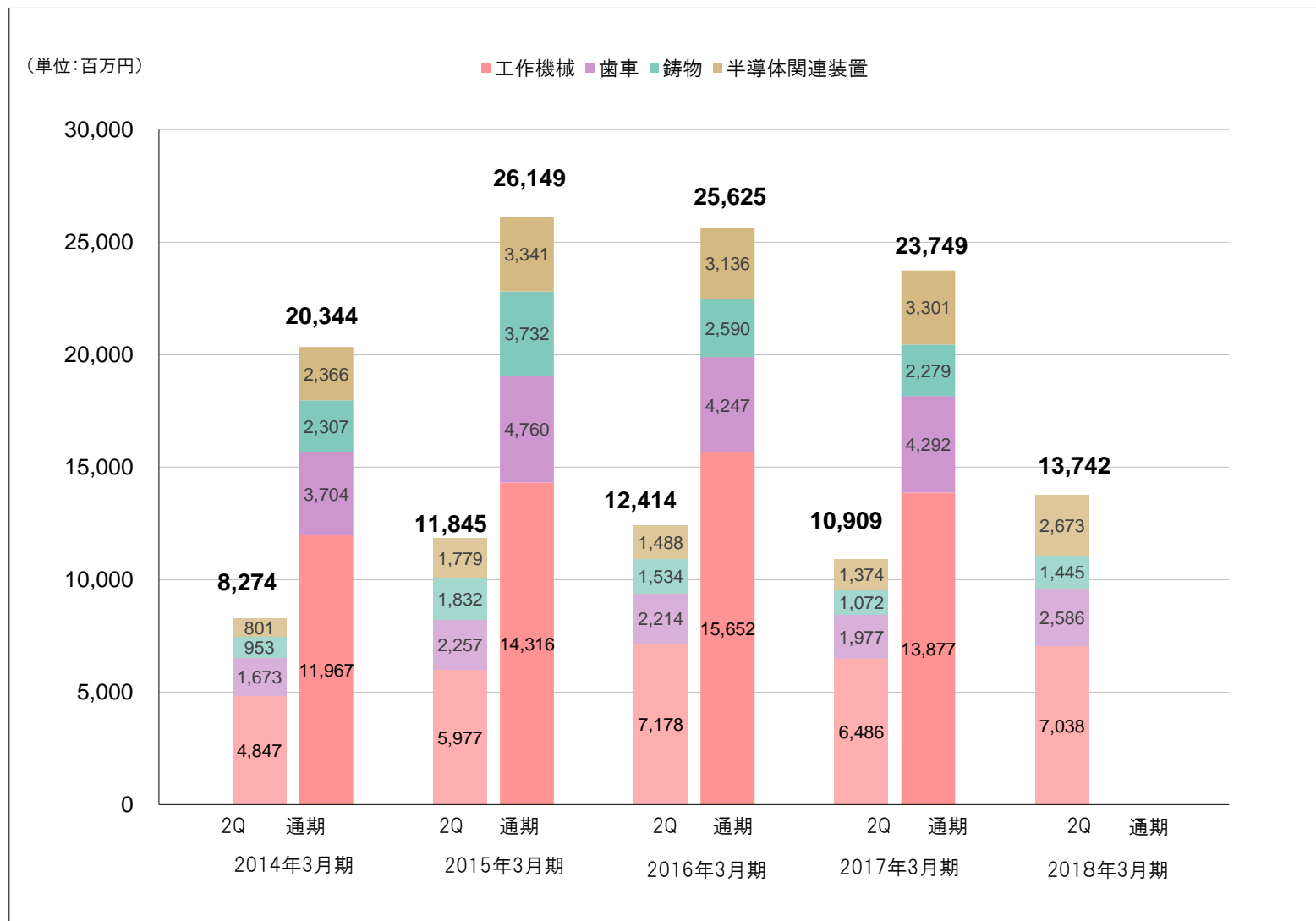
- 前期比で売上高は28億33百万円、26%増加。営業利益は4億31百万円、117.8%増加
- 投資意欲が旺盛な中国及び東アジアで半導体関連装置の販売、受注が好調
- 国内も工作機械業界や半導体関連装置業界向けに大型研削盤、高精度タイプの研削盤などが好調に推移

セグメント別売上高推移

(単位:百万円)



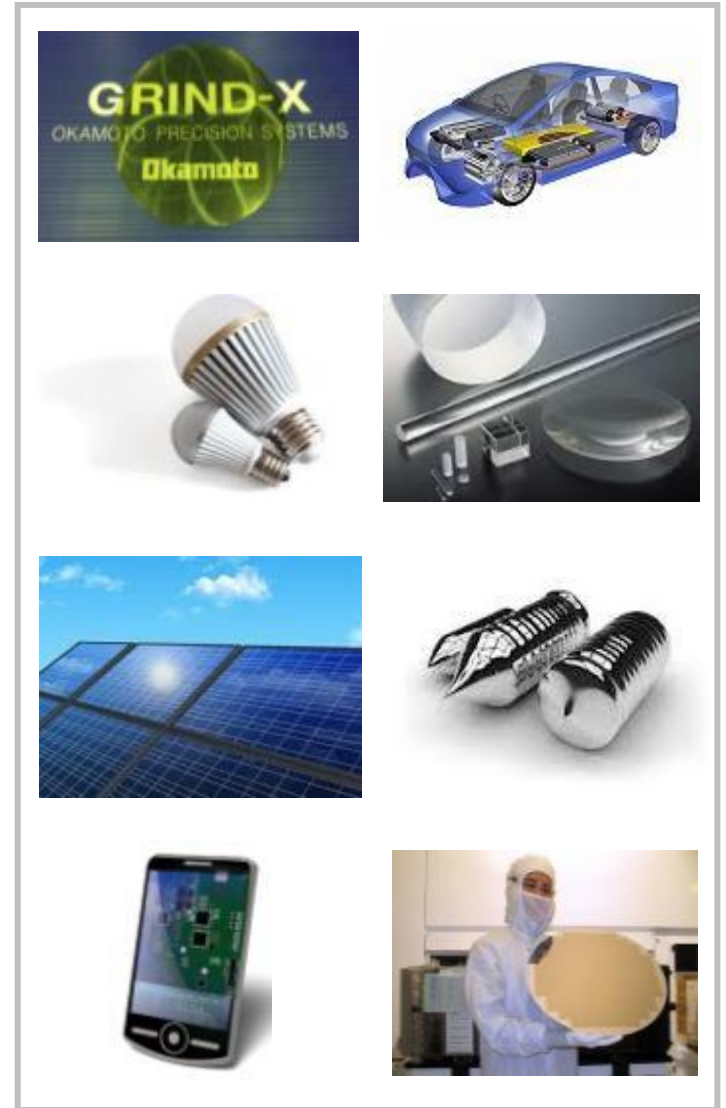
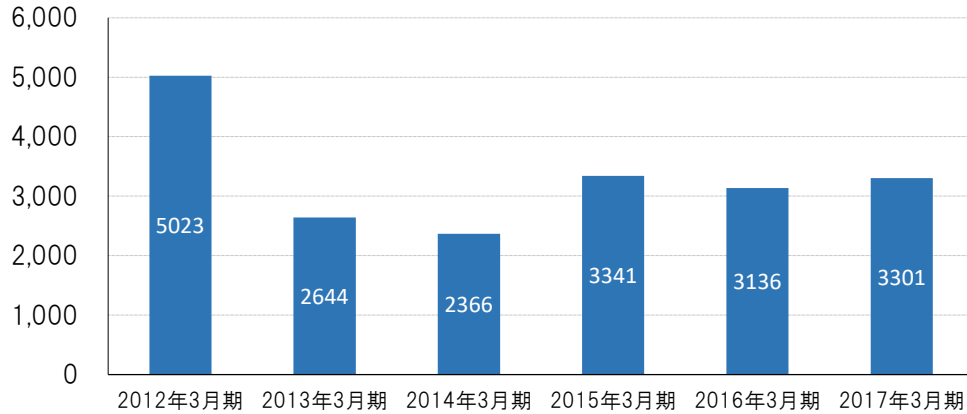
○ セグメント別売上高推移②



○ 半導体製造装置事業の状況

売上高

(単位:百万円)



○ 最新の半導体関連装置の市況

【国内市場】

- スマートフォンの高機能化や自動車のAI化等の要因により、依然として半導体の製造が活況。
これに伴うシリコンウェーハの品不足状態を受け、大型投資には慎重な大手国内メーカーにあっても、随時生産能力を補強する為の設備投資を継続中。
弊社製品においては、特にポリッシュ盤を中心とした高額装置の受注が好調。

【海外市場】

- “半導体大国”を目指し、シリコンウェーハの国産化を目指す中国においては、続々と半導体工場の新設計画が進行中。
同工場にて必要となる半導体製造装置についても、当面の間は巨額の設備投資が見込まれる。
また世界的なメモリー需要の拡大により、韓国内ウェーハメーカーからの装置受注も増加。



PNX1200

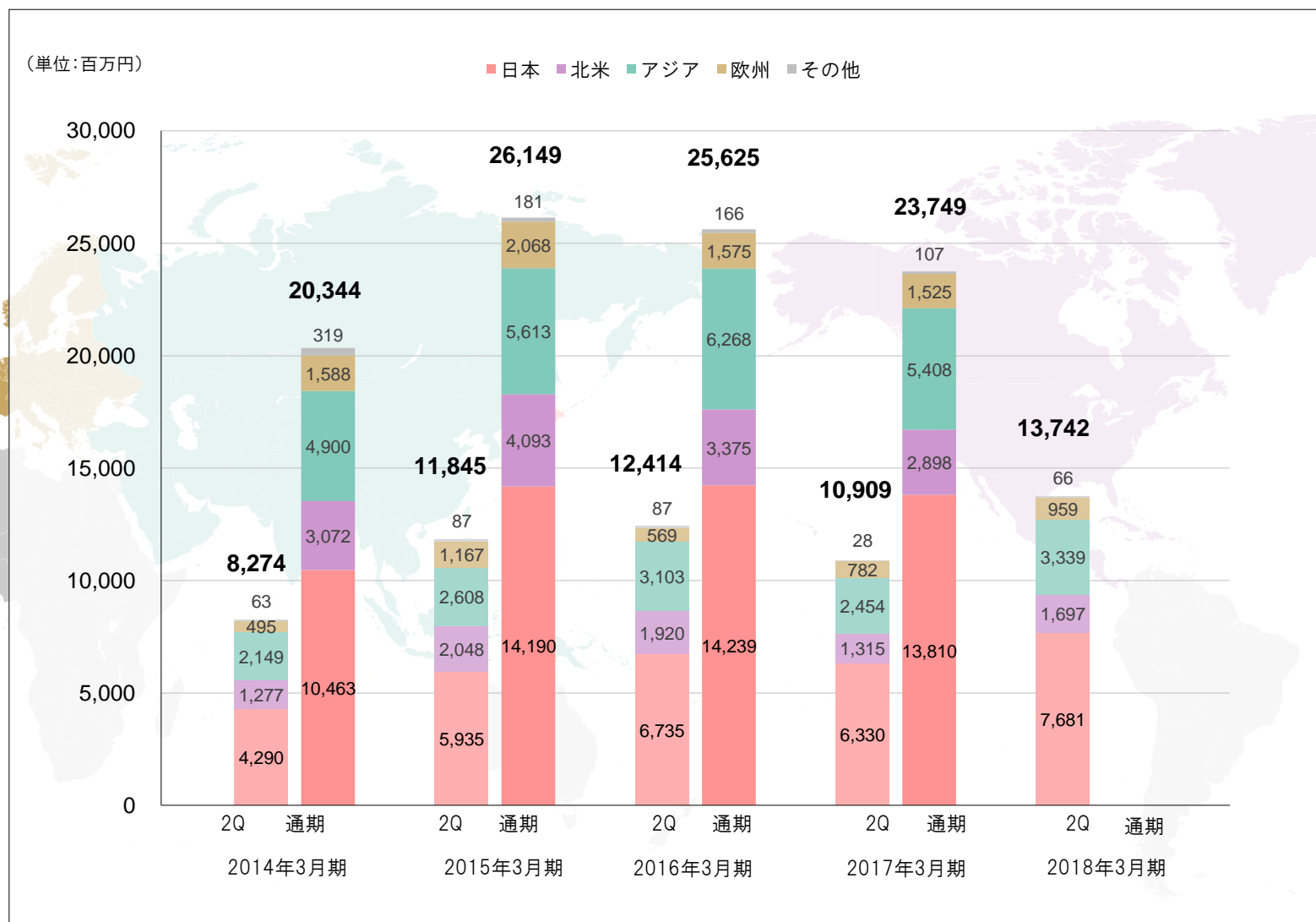


GNX300B



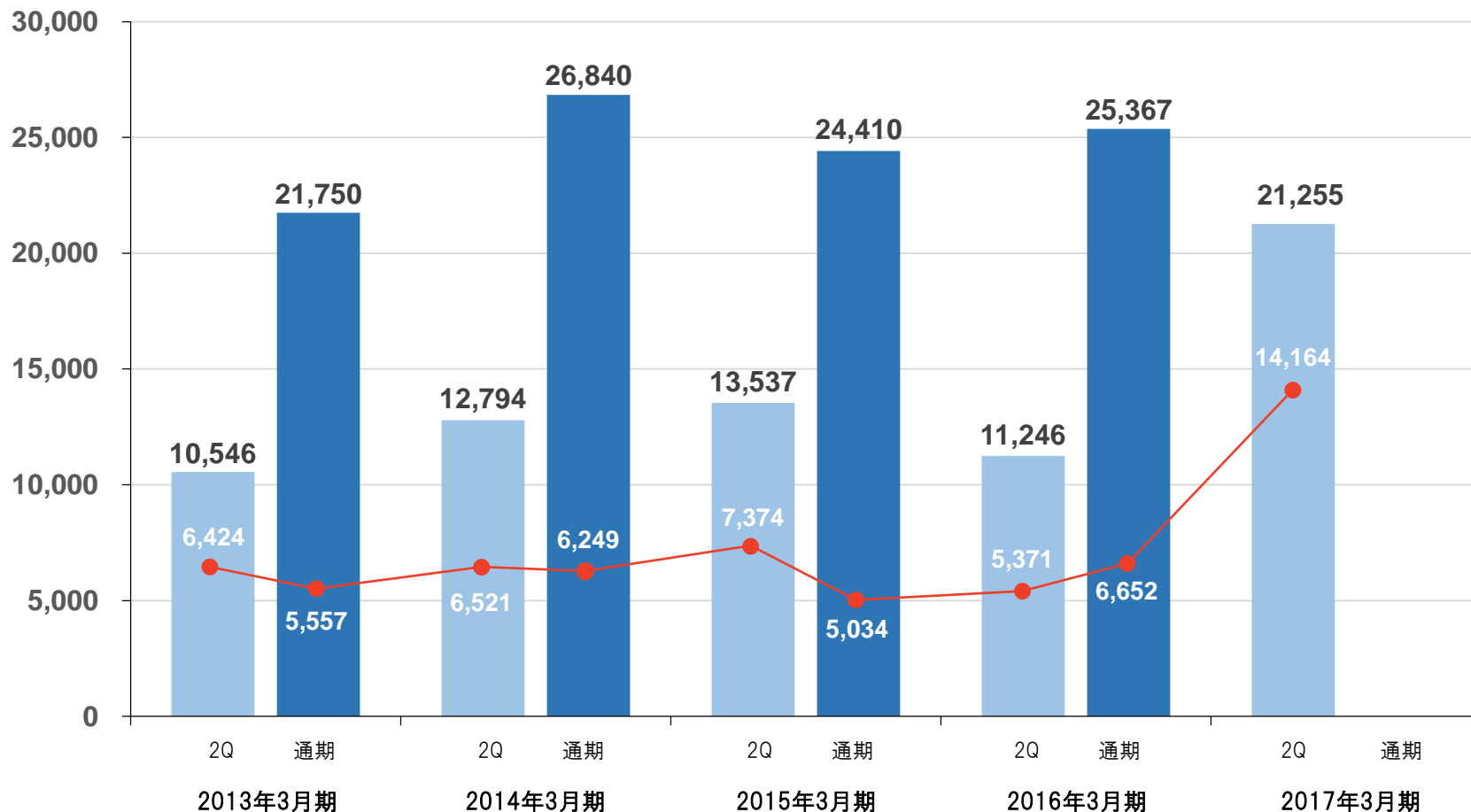
PNX332B

○ エリア別売上高推移



○ 受注・受注残高推移

(単位:百万円)



○ 比較貸借対照表

(単位:百万円)

	2017年3月	2017年9月	
	金額	金額	対前期末比
流動資産	18,233	18,908	+675
現金及び預金	3,699	4,027	+328
受取手形及び売掛金	7,661	7,508	▲153
棚卸資産	6,472	6,964	+492
有形・無形固定資産	9,630	9,807	+177
投資等	409	442	+33
資産合計	28,273	29,158	+885

(単位:百万円)

	2017年3月	2017年9月	
	金額	金額	対前期末比
負債合計	18,803	19,112	+309
流動負債	13,793	14,851	+1,058
固定負債	5,009	4,260	▲749
純資産合計	9,470	10,046	+576
負債資本合計	28,273	29,158	+885

<総資産(前期末比+855m)>

- 流動資産の増加 675m
- ・ 受取手形・売掛金の減少 ▲153m …… 売掛金回収による減少
- ・ 現預金の増加 328m
- ・ 棚卸資産の増加 492m
- 有形・無形固定資産の増加 177m

<負債(前期末比+309m)>

- 支払手形・買掛金の増加 900m …… 仕入の増加
- 借入金減少 ▲1,069m …… (連結)調達/330m⇔返済/▲1,488m
- 前受金の増加 151m

<純資産(前期末比+576m)>

- 当期純利益 +514m、為替換算調整勘定 +237m
- 配当金の支払い ▲177m

○ 比較キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

	2017年3月		2017年9月	
	金額		金額	対前期末増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,181		2,376	+1,195
税引前当期純利益	850		695	▲155
減価償却費	1,158		587	▲571
売上債権の増減 (▲は増加)	▲444		245	+689
棚卸資産の増減 (▲は増加)	▲183		▲354	▲171
仕入債務の増減 (▲は減少)	61		863	+802
その他	▲261		338	+599
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲772		▲542	+230
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲631		▲1,457	▲826
換算差額	16		54	+38
現金・同等物残高	3,305		3,736	+431

■ 現金・同等物は、前期末比431m増加の3,736m

- 営業CF 2,376m
・税引前当期純利益 695m、売上債権の減少 245m・・・売上債権回収による減少、仕入債務の増加 863m
- 投資CF ▲542m
・設備投資 引き続き岡本工機新工場関連の投資など
- 財務CF ▲1,457m

III

2018年3月期 業績予想

2Q好調も通期予想は保守的に据え置き

(単位:百万円、%)

	2017年3月	2018年3月	
	金額	金額	前期比増減率
売上高	23,749	28,000	+17.9%
売上総利益	7,085	8,500	+20.0%
販売費及び一般管理費	5,945	6,900	+16.0%
営業利益	1,139	1,600	+40.4%
経常利益	768	1,350	+75.7%
当期純利益	577	1,100	+90.5%

※小数点第2位を四捨五入

(単位:百万円)

	2017年3月	2018年3月 (予想)
	金額	金額
設備投資額	960	1,235
減価償却費	1,158	1,126
研究開発費	106	119

為替レート	2017年3月	2018年3月 (予想)
米ドル	108.72	112
シンガポールドル	78.39	79
ユーロ	118.68	120
タイバーツ	3.10	3.20
人民元	16.10	16.30

※期中の平均レートで記載しております。

○ 2018年3月期の市場環境見通し

【国内市場】

- 半導体関連装置、自動車、航空機、医療関連で工作機械の受注は増加を予想
歯車はロボット関連での受注増加を見込む

【海外市場】

- 北米は引き続き自動車、航空機関連を中心に底堅い動き
- 欧州はロシアに不透明感残るもフランス、イタリア、ドイツなど堅調
- アジアは省人化、高精度化など中国で引き続いての受注増加を予想

【半導体】

- 半導体関連装置は更なる受注増加を予想、特に引き続き中国の受注増加に期待

IV

中期経営計画と進捗状況

Mission GX2019

○ 中期経営計画施策 営業

セグメント	施策
工作機械	①海外販売の強化(北米、中国を戦略拠点に) ②新規開発機種重点販売 ③国内外の販売シェアの拡大
半導体関連装置	①ポリッシュ装置重点販売 ②次世代パワー半導体用SiC、GaN サファイア等の脆性材加工装置の拡販
工作機械(歯車)	①拡大するロボット、自動車市場への拡販 ⇒ 岡本工機 新工場立ち上げ
工作機械(鋳物)	①新規顧客の開拓

○ 具体的施策 海外販売の強化 今期進捗状況

米国・中国で販売順調に推移

米国

- ◆ 4拠点でのショールーム活用で、来客数も増加し販売に貢献
- ◆ 汎用機の特販・大型機の更新需要もあり、販売台数の増加
- ◆ 半導体装置関連用セラミック、オイル・ガス関連用向け部品加工需要増加
- ◆ 自動化対応専任者を採用し、自動化の提案を拡大中

中国

- ◆ 中国内生産を開始、見える化により認知度及び顧客の安心感が高まり販売も順調に推移
- ◆ 自動化需要であるロボット部品の特殊部品加工で認知度が上がり、販売拡大
- ◆ 営業部員を増員して販売力を強化

○ 具体的施策 戦略機種への投入

複合研削盤、サドル型、コラム型新シリーズの投入進む

≫ 複合研削盤(円筒研削盤ベース)

- ・今上期に出荷
- ・国内外からの引き合い多数



≫ サドル/コラム型平面研削盤の新シリーズ

- ・次期主力機種となる PSG-SA1/CA1シリーズの販売を開始し、受注の滑り出し好調



≫ 大型平面研削盤のコストダウン機

- ・今下期に入り、静圧スライド高精度機の受注増
- ・今後はコストダウン効果による利益率の拡大に期待



○ 中期経営計画施策 技術・生産

施策

1. 品質向上
2. 平準化
3. サービス体制の強化
4. コストダウン
5. 効率化

具体的施策

- ◆ QCD改善活動を通じ変動費を削減する
- ◆ 規格・モジュール化推進による品質の向上とコストダウン
- ◆ 3D CAD化推進による設計効率化と品質の向上
- ◆ 集中サービスセンターによるパーツ即納体制を確立
- ◆ 歯車生産のライン化、自動化による、品質安定、効率化
- ◆ 管理系システム再構築による効率化、品質向上

QCD改善活動によるコスト抑制進展

1. QCD改善活動を通じた変動費の削減

Q(品質)、C(コスト)、D(納期)

- ・ 初期クレームの削減
119期は前期と同一水準で推移
- ・ 資材調達機能強化（グローバル調達含む）
119期目標を上回り順調に推移
- ・ 平準化と生産性向上による内製化の推進
119期目標に対し順調に推移、半導体部品加工内製も順調

QCD改善活動全施策による変動費削減実績は、計画通りに推移

○ 中期事業計画の骨子 ～ 技術・生産 進捗状況②

モジュール化、3D CAD化などの推進も順調に進捗

2. 規格・モジュール化推進による品質の向上とコストダウン

- ・引き続き、社内標準規格の充実化を推進中
- ・主要平面研削盤シリーズであるCA及びCHシリーズにおいて、ユニットモジュールを使用することによりで構造の選択を容易にし、後工程を簡素化できる設計スタイルを構築

3. 3D CAD化推進による設計効率と品質の向上

- ・社内/外注加工における3Dデータの活用率向上により、短納期化とコストダウンに寄与
- ・新機種開発時の機械剛性確認における3D解析ソフトの使用が定着

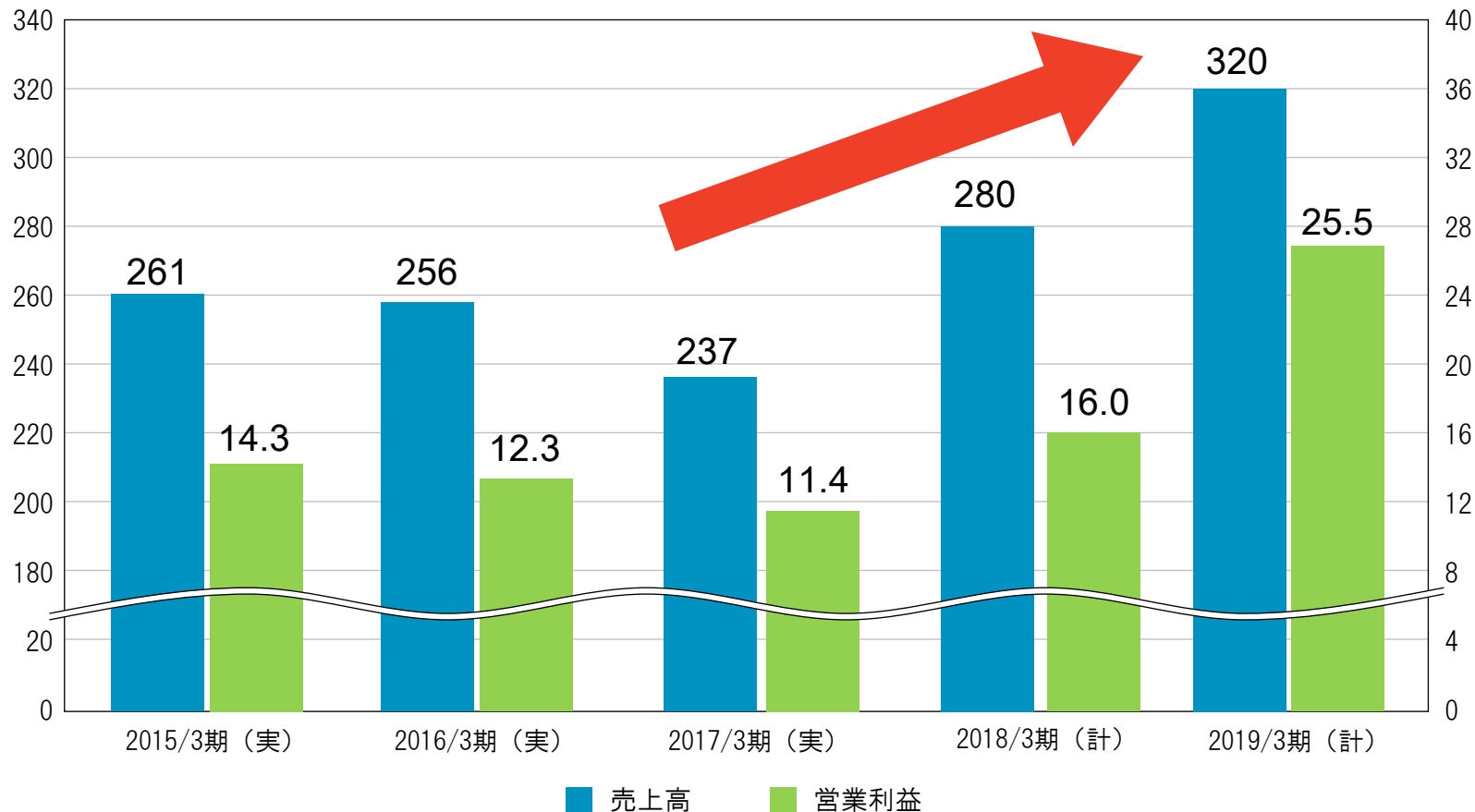
4. 集中サービスセンターによるパーツ即納体制を確立

- ・インフラ整備と、半導体サービス増員による強化

○ 中期目標

売上高 億円


営業利益 億円



営業利益率目標 8%

海外売上高比率 60%

究極の
平面創成



Okamoto

本資料に関するお問い合わせ先

株式会社 岡本工作機械製作所
総務部
TEL 027(385)5800

【本資料お取り扱い上のご注意】

本資料は、株式会社岡本工作機械製作所(以下、当社)をご理解いただくため、当社が作成したもので、当社への投資活動勧誘を目的としておりません。

本資料を作成するにあたっては正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

本資料中の業績予測ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果があります。